

PCT/JP2004/016009

01.11.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 0 月 3 1 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 3 7 2 9 6 3
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 3 7 2 9 6 3]

出 願 人 シャープ株式会社
Applicant(s):

REC'D 23 DEC 2004

WIPO

PCT

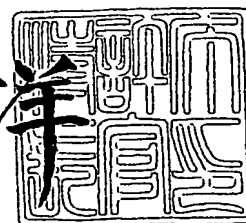
BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 2 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 1 1 2 4 6 1

【書類名】 特許願
【整理番号】 03J03144
【提出日】 平成15年10月31日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01L 23/31
G02B 6/46

【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内
【氏名】 藤田 英明

【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内
【氏名】 岩木 哲男

【発明者】
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内
【氏名】 石井 頼成

【特許出願人】
【識別番号】 000005049
【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】
【識別番号】 100075557
【弁理士】
【フリガナ】 サイキョウ
【氏名又は名称】 西教 圭一郎
【電話番号】 06-6268-1171

【選任した代理人】
【識別番号】 100072235
【弁理士】
【氏名又は名称】 杉山 毅至

【選任した代理人】
【識別番号】 100101638
【弁理士】
【氏名又は名称】 廣瀬 峰太郎

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 009106
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0208451

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

予め定める光路に沿って進む光が貫通する透光部を有する搭載体と、
受光または発光する光学面が透光部に臨み、透光部の軸線方向一端部を塞いで搭載体に
搭載される光学素子と、

光路を除く領域に形成され、搭載体に搭載される光学素子を封止する封止体とを含むこ
とを特徴とする光学素子の封止構造体。

【請求項 2】

封止体には、光学素子の耐環境性を向上する物質が添加されることを特徴とする請求項
1 記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 3】

光学素子に電氣的に接続される接続体と、
光学素子と接続体とを電氣的に接続するワイヤとをさらに含み、
前記封止体の線膨張係数は、ワイヤまたは光学素子の線膨張係数とほぼ同等に設定され
ることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 4】

前記封止体は、光学素子に関して搭載体と反対側の領域に形成されることを特徴とする
請求項 1～3 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 5】

前記封止体よりも光透過率の高い透過体をさらに含み、透過体は、透光部の軸線方向他
端部を塞ぐことを特徴とする請求項 1～4 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止構造体
。

【請求項 6】

前記透過体が搭載体に接触する第 1 接触面積は、透過体が封止体に接触する第 2 接触面
積よりも大きいことを特徴とする請求項 5 記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 7】

前記透過体は、外周部の少なくとも一部が搭載体に接触することを特徴とする請求項 5
または 6 記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 8】

前記透過体は、封止体と搭載体とを覆うこと特徴とする請求項 5～7 のいずれか 1 つに
記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 9】

前記透過体は、レンズ形状に形成されるレンズ部分が光路上に形成されることを特徴と
する請求項 5～8 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 10】

前記搭載体は、リードフレームと、サブマウントとを含み、
光学素子は、サブマウントを介してリードフレームに搭載されることを特徴とする請求
項 1～9 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 11】

前記搭載体の透光部は、光学素子の光学面に向かうにつれて光路を絞る集光部分が形成
されることを特徴する請求項 1～10 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 12】

前記透光部は、光路に沿って延びる開口を形成し、光学面から遠ざかるにつれて内周径
が拡張して形成され、その内周面が高い光反射率を有することを特徴とする請求項 1～1
1 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止構造体。

【請求項 13】

前記光学素子は、発光ダイオード、半導体レーザおよびフォトダイオードのうちのいず
れか 1 つであることを特徴とする請求項 1～12 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止
構造体。

【請求項 14】

請求項 1～13 のいずれか 1 つに記載の光学素子の封止構造体を有し、光伝達媒体と光的に結合可能な光結合器。

【請求項 15】

受光または発光する光学面を有する光学素子を、搭載体に搭載し、搭載体に搭載される光学素子をモールド樹脂によって封止する光学素子の封止方法であって、

搭載体に、予め定める光路に沿って進む光が貫通する透光部を形成する透光部形成工程と、

光学面を透光部に臨ませ、光学素子によって透光部の軸線方向一端部を塞いだ状態で、光学素子を搭載体に搭載する半導体搭載工程と、

光学素子が搭載される搭載体を金型に装着し、金型によって透光部の軸線方向他端部を塞いだ状態で、光学素子の耐環境性を向上する充填材を添加した封止用モールド樹脂を金型内に注入する封止用モールド樹脂成形工程を有することを特徴とする光学素子の封止方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】光学素子の封止構造体および光結合器ならびに光学素子の封止方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、光学素子が封止される光学素子の封止構造体に関する。たとえば光ファイバを伝送媒体として光信号を送受信する光通信リンクなどに用いられる光結合器の封止構造体に関する。

【背景技術】

【0002】

機器間、家庭内および自動車内での光通信を行うために、光結合器が用いられる。光結合器は、光学素子と、光ファイバとを光学的に結合させる装置である。たとえば光学素子は、発光ダイオード（LED、Light Emitting Diode）またはフォトダイオード（PD、Photo Diode）などである。光結合器は、光学素子がモールド樹脂によって封止される封止構造体を有する。

【0003】

図11は、第1の従来技術の封止構造体1を示す断面図である。特許文献1の図3には、第1の従来技術の封止構造体1が開示される。この封止構造体1は、リードフレーム3に光学素子2が搭載され、その光学素子2が透明な封止樹脂4で覆われる。封止樹脂4には、光学素子2の光学面5に対向する位置にレンズ部分6が形成される。

【0004】

光学素子2が発光素子である場合、光学面5から出射した光は、封止樹脂4を透過する。そしてその光は、封止樹脂4のレンズ部分6によって集光されて光ファイバ7に入射する。また光学素子2が受光素子である場合、光ファイバ7から出射した光は、封止樹脂4に入射する。この光は、封止樹脂4のレンズ部分6によって集光されて、封止樹脂4を透過し、光学面5に入射する。このようにして光ファイバ7と光学素子2とが光伝達可能な状態、いわゆる光学的に結合される。

【0005】

図12は、第2の従来技術の封止構造体10を示す断面図である。特許文献1の図1には、第2の従来技術の封止構造体10が開示される。この封止構造体10は、光学素子2が、フィラーを含有する封止樹脂、すなわちフィラー含有封止樹脂8によって覆われる。フィラー含有封止樹脂8は、光学素子2に入出射する光の光路領域を除いた光路外領域に形成される。また光路領域には、透光性を有するレンズ体9が設けられる。レンズ体9は、透明樹脂またはガラスによって実現される。なお、光学面5は、光学素子2のうちリードフレーム30反対側に形成される。光学面5と光ファイバ7との間に形成される光路を進む光は、フィラー含有樹脂8に遮られることなく、レンズ体9を透過する。

【0006】

【特許文献1】特開2000-173947号公報（図1，図3）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

第1の従来技術では、光が封止樹脂4を透過する。封止樹脂4は、フィラーが含有されることで、光学素子2の耐環境性を向上させることができる。しかしながら封止樹脂4は、フィラーの含有量が増えるとともにその光透過率が低下する。光透過率が低下すると、光ファイバ7と光学素子2との間で光伝達量が低下してしまう。したがって第1の従来技術では、封止樹脂4にフィラーを含有できないか少量のフィラーしか含有させることができない。これによって封止構造体1は、光学素子2の耐環境性の向上と光伝達率の向上との両方を満たすことができないという問題がある。

【0008】

第2の従来技術では、レンズ体9をガラスによって実現した場合、モールド成形でレンズ体を形成することができず、光結合器を安価に製造することができないという問題があ

る。

【0009】

また、結合荷電素子 (CCD、Charge Coupled Device) のように、数mm～数10mm角となる比較的サイズが大きい光学素子2を用いる場合は光学面5にガラスレンズ9を配置することが可能である。しかしながら、LEDのように、数百 μ m角となるサイズが小さい光学素子2を用いると、光学面5が非常に小さいのでガラスレンズ9も非常に小さいものを使用する必要がある。

【0010】

この場合、光学的に効果が得られるレンズの設計が困難であること、微小なガラスレンズ9の作製が困難であること、光学面5とガラスレンズ9との接合および位置合せが困難であることという3つの問題がある。また、光学素子2の光学面5より大きいガラスレンズ9を用いた場合、光学面5の近傍にガラスレンズ9が接合されるため、光学面5の近傍に形成される電極とリードフレーム30とのワイヤーボンディングが困難となるという問題がある。

【0011】

また、レンズ体9を樹脂によって実現した場合、LED等のサイズが小さい光学素子2を用いる場合にはその光学面5が小さいので、レンズ体9をガラスによって実現した場合と同様の理由によって対応が困難である。さらに樹脂レンズ9を用いる場合には、レンズの耐熱性の問題から、フィラー含有封止樹脂8による封止を行った後に樹脂レンズ9を光学素子2の光学面5に接合する必要がある。

【0012】

図13は、光学素子2が搭載されたリードフレーム3を金型に装着した状態を示す。樹脂レンズ9を用いる場合には、フィラー含有封止樹脂8のモールド成形にあたって、光学素子2の光学面5にフィラー含有封止樹脂8が回り込まないようにする必要がある。このために、リードフレーム3の反りなどを考慮して、成形用金型11の対向部分12によって、光学素子2の光学面5を加圧する必要がある。

【0013】

光学面5が加圧されると、光学面5の一部が欠けたり、光学素子2の光学特性に悪影響を与えたりするおそれがある。また、光学面5の近傍に配置されるワイヤ13に対向部分12が接触するおそれがある。これを防ぐためには、高精度の金型管理とリードフレーム3の変形防止との両方を達成する必要があるが、容易に行うことはできない。特にLEDのようにサイズが小さい光学素子では、ワイヤ13を保護しつつ光学面5にフィラー含有封止樹脂8が回り込まないようにすることは、非常に困難である。

【0014】

したがって本発明の目的は、耐環境性に優れるとともに、小型化が可能な光学素子の封止構造体を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0015】

本発明は、予め定める光路に沿って進む光が貫通する透光部を有する搭載体と、受光または発光する光学面が透光部に臨み、透光部の軸線方向一端部を塞いで搭載体に搭載される光学素子と、光路を除く領域に形成され、搭載体に搭載される光学素子を封止する封止体とを含むことを特徴とする光学素子の封止構造体である。

【0016】

本発明に従えば、光学面が発光面である場合、光学面から出射した光は、透光部を貫通して搭載体から出射する。また光学面が受光面である場合、搭載体の外方から搭載体に向かって進む光は、透光部を貫通して光学素子の光学面に入射する。封止体は、光路を除く領域に形成されることによって光の進行を遮ることがない。したがって封止体は、透光性を有する必要がない。これによって有色の封止体を用いても、透光部を通過する光の光量が低下することがなく、封止体の選択肢を広げることができる。

【0017】

また光学面は、光学素子の発熱源となる。本発明では光学面は、搭載体に対向して配置されるので、光学面で生じた熱が搭載体に伝達しやすく、光学素子の放熱性を向上することができる。また光学素子のうち光学面および光学面の近傍部分は、搭載体に接触している。したがって光学素子のうち光学面および光学面の近傍部分を、封止体で封止させる必要がない。したがって光学素子が小型である場合であっても、容易に製造することができる。

【0018】

たとえば、封止体としてモールド樹脂を用いることで、モールド成形によって封止構造体を製造することができる。この場合、光学素子によって搭載体の透光部の軸線方向一端部を塞いだ状態で、光学素子を搭載体に搭載する。次に、光学素子のうち搭載体に対向する表面部以外の残余の部分を、モールド樹脂によって覆って成形加工を行う。このようにして封止構造体を製造することができる。

【0019】

また本発明は、封止体には、光学素子の耐環境性を向上する物質が添加されることを特徴とする。

【0020】

本発明に従えば、封止体は、有色であっても、光伝達率が低下することがない。したがって封止体に、光学素子の耐環境性を向上するための有色の添加剤が添加されても、光の伝達率が低下することがなく、耐環境性を向上することができる。

【0021】

たとえば耐環境性として、耐熱衝撃性および放熱性以外に、耐湿性、耐熱性、耐寒性、高温での安定動作性、低温状態での安定動作性、樹脂強度向上性が挙げられる。これらは、封止体がモールド樹脂である場合、フィラーと称される充填剤を封止体に含有することによって実現される。さらに金型離型性、難燃性および着色性を得るための材料が封止体に含有されてもよい。

【0022】

また本発明は、光学素子に電気的に接続される接続体と、光学素子と接続体とを電気的に接続するワイヤとをさらに含み、前記封止体の線膨張係数は、ワイヤまたは光学素子の線膨張係数とほぼ同等に設定されることを特徴とする。

【0023】

本発明に従えば、封止体がワイヤまたは光学素子の線膨張係数とほぼ同等に設定されることによって、温度変化に起因して、光学素子またはワイヤに生じる応力を低減させることができ、光学素子またはワイヤの損傷を防止することができる。また線膨張係数を変化させるために、封止体に有色の充填剤を添加しても、透光部を通過する光が減衰しないので、透光部を通過する光の伝達率が低下することがない。

【0024】

また本発明は、前記封止体は、光学素子に関して搭載体と反対側の領域に形成されることを特徴とする。

【0025】

本発明に従えば、封止体をモールド成形によって形成する場合、搭載体のうち、光学素子に対して反対側の表面部全面を金型の内面に接触させた状態で、金型内にモールド樹脂を注入して、モールド樹脂によって光学素子を覆って、封止構造体を製造することができる。

【0026】

また本発明は、前記封止体よりも光透過率の高い透過体をさらに含み、透過体は、透光部の軸線方向他端部を塞ぐことを特徴とする。

【0027】

本発明に従えば、透過体によって透光部の軸線方向他端部を塞ぐことによって、光学面

が露出することを防ぐことができる。また透過体は、光透過率が高いので、透光部を通過する光の伝達率の低下を抑えることができる。

【0028】

また本発明は、前記透過体が搭載体に接触する第1接触面積は、透過体が封止体に接触する第2接触面積よりも大きいことを特徴とする。

【0029】

本発明に従えば、封止体をモールド成形によって形成する場合、封止体の表面には、離型剤がしみ出た状態となる。したがって透過体は、封止体と接触している部分は密着性が低い。本発明では、第1接触面積が第2接触面積よりも大きく形成されることで、透過体の密着性を向上することができる。これによって透過体のはく離を防止することができる。

。

【0030】

また本発明は、前記透過体は、外周部の少なくとも一部が搭載体に接触することを特徴とする。

【0031】

本発明に従えば、封止体をモールド成形によって形成する場合、封止体の表面には、離型剤がしみ出た状態となる。したがって透過体は、封止体と接触している部分は密着性が低い。本発明では、外力が与えられた場合または熱変化などが生じた場合には、透過体に応力が生じる。この応力は、透過体の外周部で大きくなる。本発明に従えば、外周部の少なくとも一部が搭載体に接触することによって、応力が生じた場合に、透過体のはく離を防止することができる。

【0032】

また本発明は、前記透過体は、封止体と搭載体とを覆うこと特徴とする。

本発明に従えば、透過体によって、封止体および搭載体を覆うことによって、透過体のはく離を確実に防止することができる。

【0033】

また本発明は、前記透過体は、レンズ形状に形成されるレンズ部分が光路上に形成されることを特徴とする。

【0034】

本発明に従えば、光学面が光を発光する場合、レンズ部分によって封止構造体から出射する光の拡散を抑えることができる。また光学面が光を受光する場合、レンズ部分によって光を集光して、光学面に入射する光の光量を増やすことができる。これによって簡単な構成でかつ小型の光学系によって、光利用効率を向上することができる。

【0035】

また本発明は、前記搭載体は、リードフレームと、サブマウントとを含み、光学素子は、サブマウントを介してリードフレームに搭載されることを特徴とする。

【0036】

本発明に従えば、サブマウントを介することによって、直接リードフレームに光学素子を搭載した場合に生じる不具合を解消することができる。たとえば、リードフレームと光学素子との線膨張係数の差が大きい場合に、サブマウントの線膨張係数を光学素子に近づけることによって、温度変化に起因して生じる光学素子の応力を低減することができる。またリードフレームに比べて寸法精度を向上することができる。

【0037】

また本発明は、前記搭載体の透光部は、光学素子の光学面に向かうにつれて光路を絞る集光部分が形成されることを特徴とする。

【0038】

本発明に従えば、光学面が光を発光する場合、集光部分によって封止構造体から出射する光の拡散を抑えることができる。また光学面が光を受光する場合、集光部分によって光を集光して、光学面に入射する光の光量を増やすことができる。これによって簡単な構成でかつ小型の光学系によって、光利用効率を向上することができる。

【0039】

また本発明は、前記透光部は、光路に沿って延びる開口を形成し、光学面から遠ざかるにつれて内周径が拡径して形成され、その内周面が高い光反射率を有することを特徴とする。

【0040】

本発明に従えば、搭載体に入射する光の光径が光学面よりも大きい場合、光学面に入射する光は、内周面で光が反射することによって、光学面に入射する光の光量を増やすことができる。また光学面から出射する光の拡散する角度が大きい場合、搭載体から出射する光は、内周面で光が反射することによって、搭載体から拡散する光の角度を小さくすることができる。

【0041】

また本発明は、前記光学素子は、発光ダイオード、半導体レーザおよびフォトダイオードのうちのいずれか1つであることを特徴とする。

【0042】

本発明に従えば、光学素子が発光ダイオード、半導体レーザおよびフォトダイオードのうちのいずれかのような小型素子である場合であっても、光学素子を搭載体に搭載した状態で、光学素子を封止体によって封止することができる。

【0043】

また本発明は、前記光学素子の封止構造体を有し、光伝達媒体と光的に結合可能な光結合器である。

【0044】

本発明に従えば、上述した封止構造体を光結合器が備えることによって、耐環境性に優れるとともに、小型化が可能な光結合器を形成することができる。

【0045】

また本発明は、受光または発光する光学面を有する光学素子を、搭載体に搭載し、搭載体に搭載される光学素子をモールド樹脂によって封止する光学素子の封止方法であって、搭載体に、予め定める光路に沿って進む光が貫通する透光部を形成する透光部形成工程と、

光学面を透光部に臨ませ、光学素子によって透光部の軸線方向一端部を塞いだ状態で、光学素子を搭載体に搭載する半導体搭載工程と、

光学素子が搭載される搭載体を金型に装着し、金型によって透光部の軸線方向他端部を塞いだ状態で、光学素子の耐環境性を向上する充填材を添加した封止用モールド樹脂を金型内に注入する封止用モールド樹脂成形工程を有することを特徴とする光学素子の封止方法である。

【0046】

本発明に従えば、透光部形成工程によって透光部を形成した後、透光部の軸線方向一端部を光学素子によって塞いだ状態で、搭載体に光学素子を搭載する。次に、封止用モールド樹脂を金型内に注入して封止体を形成する。これによって封止用モールド樹脂が光学面およびその近傍に進入することを防ぐことができる。また封止用モールド樹脂は光路から除いた領域に形成することによって、耐環境性を向上するための添加材を含有した有色の封止用モールド樹脂によって光学素子を封止しても、光伝達率の低下を防ぐことができる。

。

【0047】

また封止体によって光学素子を封止する場合、搭載体に搭載した光学素子の周囲を覆うように封止用モールド樹脂を注入するだけでよく、金型を光学素子の光学面に接触させる必要がない。これによって金型を高精度に管理する必要がない。また光学素子が損傷することを防ぐことができる。これによって光学素子が小型であっても、封止体によって光学素子を容易に封止することができる。

【発明の効果】

【0048】

本発明によれば、有色の封止体を用いても、透光部を通過する光の光量が低下することがなく、封止体の選択肢を広げることができる。たとえば光学素子が破損しにくい封止体を選択することができる。また光学面が搭載体に対向して配置されることによって、光学面で生じた熱が搭載体に伝わりやすく、光学素子の放熱性を向上することができる。これによって光学素子の故障を低減することができる。また光学素子のうち光学面および光学面の近傍部分は、搭載体に接触している。したがって光学素子のうち光学面および光学面の近傍部分を、封止体で封止させる必要がない。したがって光学素子が小型である場合であっても、容易に製造することができる。

【0049】

また封止体としてモールド樹脂を用いて、モールド成形によって封止構造体を製造することができる。この場合、光学素子によって搭載体の透光部の軸線方向一端部を塞いだ後で、モールド樹脂による成形加工を行うことで、モールド樹脂が光学面および光路に浸入することを防ぐことができる。また光学素子のうち搭載体に対向する表面部以外の残余の部分、モールド樹脂によって覆って成形加工を行うことで、光学素子と金型とを接触させる必要がない。これによって金型の精度管理を厳密に行わなくても、光学素子が成形時に破損することを防ぎ、不良品を低減して容易に形成することができる。特に、金型と光学素子とを接触させる必要がないので、光学素子が小型であっても、安易な製造方法を用いて封止構造体を製造することができる。

【0050】

また本発明によれば、耐環境性を向上するために有色の添加剤を封止体に添加しても、光の伝達率が低下することがない。したがって耐環境性の向上と、光の伝達率の維持とを両立することができ、品質を向上することができる。

【0051】

また本発明によれば、光の伝達率を低下することなく、光学素子またはワイヤに生じる応力を低減させることができる。これによって光の伝達率を維持したうえで、光学素子またはワイヤの破損を防ぐことができ、封止構造体の信頼性を向上することができる。

【0052】

また本発明によれば、封止体をモールド成形によって形成すると、搭載体のうち、光学素子に対して反対側の表面部全面を金型の内面に接触させることができ、金型を複雑な形状にする必要がない。したがって簡単に封止体を形成することができる。また搭載体のうち、光学素子に対して反対側の表面部にモールド樹脂が回り込むことが防がれ、光路にモールド樹脂が浸入することを防ぐことができる。

【0053】

また本発明によれば、光学面の露出を防ぐことによって、水分や不純物が光学面に付着することを防ぐことができる。水分の光学面への浸入を防ぐことによって、封止構造体の耐湿性を向上することができる。

【0054】

また本発明によれば、第1接触面積が第2接触面積よりも大きく形成されることで、透過体と、搭載体および封止体との密着性を向上することができる。これによって温度変化および外力などに起因して、透過体が、搭載体および封止体からはく離することを防ぐことができる。またはく離に起因して水分が封止構造体内に浸入することを防止することができ、耐湿性を向上することができる。

【0055】

また本発明によれば、透過体の外周部の少なくとも一部が、搭載体に接触することによって、応力が生じた場合に透過体が、搭載体および封止体から剥離することを防ぐことができる。またはく離に起因して水分が封止構造体内に浸入することを防止することができる。耐湿性を向上することができる。

【0056】

なお、光進行方向に垂直な仮想切断面に沿って透過体を切断した場合に、その切断面が長方形に形成される場合には、少なくともその短辺側端部と搭載体とが接触することが好

ましい。これによって透過体のうち、応力集中が生じやすい部分を搭載体に接触させることができ、透過体が剥離することをさらに防ぐことができる。言換えると、透過体のうち応力集中が生じる部分を、搭載体に接触させることが好ましい。

【0057】

また本発明によれば、透過体によって、封止体および搭載体を覆うことによって、透過体が、封止体および搭載体からはく離することを確実に防止することができる。またはく離に起因して水分が封止構造体内に浸入することを防止することができ、耐湿性を向上することができる。

【0058】

また本発明によれば、レンズ部分によって光路に沿って進行する光を屈曲することで、簡単な構成でかつ小型の光学系によって、光利用効率を向上することができる。

【0059】

また本発明によれば、サブマウントを介することによって、直接リードフレームに光学素子を搭載した場合に生じる不具合を解消することができる。たとえば、リードフレームと光学素子との線膨張係数の差が大きい場合に、サブマウントの線膨張係数を光学素子に近づけることによって、温度変化に起因して生じる光学素子の応力を低減することができる。

【0060】

またサブマウントを用いることによって、特殊な機能を付加することができる。たとえば透光性を有する材料によってサブマウントを実現してもよく、これによって光学面が露出することを防止することができる。またサブマウントにレンズを形成してもよく、これによって光利用効率を向上することができる。また光学素子の電極と電気的に結合する電極を形成してもよく、これによって特別な光学素子を用いる必要がない。

【0061】

また本発明によれば、搭載体の集光部分によって光路に沿って進行する光を屈曲することで、簡単な構成でかつ小型の光学系によって、光利用効率を向上することができる。

【0062】

また本発明によれば、集光機能を得るために、透光部に内周径が光学面から遠ざかるにつれて拡径する開口を形成するだけでよい。透光部は、エッチングやプレス加工などによって形成することができる。すなわちリードフレームのパターンニング加工とともに形成することができ、別途新たな工程を必要としない。これによって価格を増大させることなく、低コストで封止構造体に集光機能を付加することができる。

【0063】

また本発明によれば、光学素子が発光ダイオード、半導体レーザおよびフォトダイオードのうちのいずれかのような小型素子である場合であっても、光学素子を搭載体に搭載した状態で、光学素子を封止体によって封止することができる。

【0064】

また本発明によれば、上述した封止構造体を光結合器が備えることによって、耐環境性に優れるとともに、小型化が可能な光結合器を形成することができる。

【0065】

また本発明によれば、透光部形成工程によって透光部を形成した後、透光部の軸線方向一端部を光学素子によって塞いだ状態で、搭載体に光学素子を搭載する。次に、封止用モールド樹脂を金型内に注入して封止体を形成する。これによって封止用モールド樹脂が光学面およびその近傍に進入することを防ぐことができる。また封止用モールド樹脂は光路から除いた領域に形成することによって、耐環境性を向上するための添加材を含有した有色の封止用モールド樹脂によって光学素子を封止しても、光伝達率の低下を防ぐことができる。

【0066】

また封止体によって光学素子を封止する場合、搭載体に搭載した光学素子の周囲を覆うように封止用モールド樹脂を注入するだけでよく、金型を光学素子の光学面に接触させる

必要がない。これによって金型を高精度に管理する必要がない。また光学素子が損傷することを防ぐことができる。これによって光学素子が小型であっても、封止体によって光学素子を容易に封止することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0067】

図1は、本発明の実施の第1形態である封止構造体20を示す断面図であり、図2は、封止構造体20を備える光結合器21を示す断面図である。光結合器21は、光通信を行うために、光学素子22と光ファイバ23とを光伝達可能に接続する、いわゆる光学的に結合させる装置である。光学素子22は、光学機能を有する半導体であって、たとえば発光ダイオード(LED、Light Emitting Diode)などの発光素子およびフォトダイオード(PD、Photo Diode)などの受光素子である。

【0068】

光ファイバ23は、可撓性を有して長尺状に形成されるケーブルである。光ファイバ23は、一端部から他端部に向けて光を伝達する光伝達媒体となる。すなわち光ファイバ23の一端部から入射した光は、光ファイバ23内を通過し、光ファイバ23の他端部から出射する。光ファイバ23の一端部の外周部分24は、プラグ25によって覆われる。プラグ25は、光結合器21に結合するための結合部となる。

【0069】

光結合器21は、プラグ25が着脱自在に嵌合するコネクタ部26が形成される。プラグ25がコネクタ部26に嵌合した状態では、光ファイバ23の一端面27が光学素子22と対向した位置に配置される。すなわちコネクタ部26にプラグ25が接続されると、光ファイバ23は、光学素子22に対して位置合せされた状態となる。

【0070】

光結合器21は、光学素子22を封止体29によって封止した封止構造体20を有する。封止構造体20は、光学素子22を保護する。封止構造体20とコネクタ部26とは、一体に固定される。コネクタ部26に光ファイバ23を嵌合することで、光ファイバ23と光学素子22との位置ずれを防ぐことができる。また光ファイバ23と光学素子22との位置合せを容易に行うことができる。

【0071】

図1に示すように、封止構造体20は、光学素子22と、リードフレーム30と、封止体29と、透過体31と、ドライバ回路32と、ワイヤ33とを含んで構成される。リードフレーム30は、光学素子搭載部34と、内部接続部35と、外部接続部36とを含む。光学素子搭載部34は、いわゆるダイパッドであってもよい。また内部接続部35は、いわゆるインナーリードであってもよい。また外部接続部36は、いわゆるアウターリードであってもよい。このようなリードフレーム30は、板状に形成される。以後、リードフレーム30の厚み方向を単に厚み方向Aと称する。なお、本実施の形態では、リードフレーム30の光学素子搭載部34は、厚み方向一方A1側の表面部に光学素子22を搭載する搭載体となる。

【0072】

光学素子22の電極端子と光学素子搭載部34の電極端子とは、電氣的に導通した状態で接着される。光学素子搭載部34の電極端子は、第1ワイヤ33aによって、対応する内部接続部35aに電氣的に接続される。第1ワイヤ33aによって接続される内部接続部35aは、対応する外部接続部36aに連なり、封止構造体20の外方に露出する。これによって封止構造体20の外部の装置から外部接続部36aを介して光学素子22に電気信号を与えることができる。また光学素子22から外部接続部36aを介して封止構造体20の外部の装置に電気信号を与えることができる。なお、光学素子22の電極端子と内部接続部35aとが、第1ワイヤ33aによって電氣的に直接接続されてもよい。

【0073】

ドライバ回路32の電極端子と他の内部接続部35bは、電氣的に導通した状態で接着される。ドライバ回路32の電極端子は、第2ワイヤ33bによって、光学素子22の他

の電極端子と電気的に接続される。これによってドライバ回路 32 は、光学素子 22 に電気信号を与えることができ、光学素子 22 の駆動および制御を行うことができる。ドライバ回路 32 は、他の内部接続部 35b に連なる外部接続部 36b を介して、外部の装置と電気的に接続されてもよい。

【0074】

光学素子搭載部 34 は、厚み方向 A に貫通する開口 37 を形成する透光部 38 を有する。光ファイバ 23 と光学素子 22 とにわたって進行する光は、予め定める光路 80 に沿って進む。この光は、透光部 38 の開口 37 を通過する。光学素子 22 は、透光部 38 のうち軸線方向一端部 48 を塞ぎ、光学素子搭載部 34 の厚み方向一方 A1 側の表面部 39 に接着される。なお、透光部 38 の軸線方向一端部 48 は、透光部 38 の厚み方向一方 A1 側端部となる。

【0075】

光学素子 22 は、光学面 41 を有する。光学素子 22 が発光素子、たとえば LED である場合、光学面 41 は、発光面となる。また光学素子 22 が受光素子、たとえば PD である場合、光学面 41 は、受光面となる。光学面 41 は、厚み方向一方 A1 側から透光部 38 に臨み、光路 80 の延長線上に配置される。このように光学素子 22 は、光学面 41 がリードフレーム 30 の光学素子搭載部 34 に対向する。このような光学素子 22 とリードフレーム 30 との配置状態を、フェースダウン配置という場合がある。

【0076】

封止体 29 は、光学素子 22 およびドライバ回路 32 に関して、リードフレーム 30 の反対側から、光学素子 22 およびドライバ回路 32 を覆う。したがって封止体 29 は、光学素子 22 の厚み方向一方 A1 側部分を塞ぎ、封止体 29 のうち厚み方向他方側 A2 で光学素子 22 を覆う。

【0077】

封止体 29 は、少なくとも、光路 80 を除く領域に形成される。封止体 29 は、封止構造体 20 の耐環境性を向上する添加剤が含有される。具体的には、封止体 29 は、フィラーが添加される封止用モールド樹脂から成る。封止体 29 は、フィラーが添加されることによって、線膨張係数や熱伝達率が設定可能である。

【0078】

封止体 29 の線膨張係数を、被搭載体である光学素子 22、ワイヤ 33 およびドライバ回路 32 の線膨張係数に近づけることによって、被搭載体 22、32、33 の耐熱衝撃性を向上することができる。なお、それぞれの被搭載体 22、32、33 の線膨張係数が異なっている場合には、それらの被搭載体 22、32、33 の損傷が最も少なくなるように、封止体 29 の線膨張係数が最適に設定される。たとえば封止体 29 の線膨張係数は、ワイヤ 33 または光学素子 22 の線膨張係数とほぼ同等に設定される。ほぼ同等とは、一致する場合も含む。これによって被搭載体 22、32、33 の損傷を小さくすることができる。また封止体 29 の熱伝達率を大きく設定することによって、被搭載体 22、32、33 の放熱性を向上することができる。

【0079】

透過体 31 は、リードフレーム 30 の厚み方向他方 A2 の表面部 47 を覆う。透過体 31 は、少なくとも透光部 38 の軸線方向他端部 49 を塞ぐ。透過体 31 は、高い光透過率を有し、少なくとも封止体 29 よりも高い光透過率を有する。また透過体 31 には、レンズ形状に形成されるレンズ部分 42 が光路 80 上に形成される。レンズ部分 42 は、光路 80 の中心に向かうにつれて厚み方向寸法が増加し、いわゆる凸レンズとして形成される。

【0080】

光学素子 22 が受光素子の場合、レンズ部分 42 は、光ファイバ 23 の一端面 27 から出射した光を受光素子 22 の受光面 41 で集光するように、屈折率および焦点距離が決定されることが好ましい。同様に光学素子 22 が発光素子の場合、レンズ部分 42 は、発光素子 22 の発光面 42 から出射した光の拡散を抑えて、光ファイバ 23 の一端面 27 に入

射する光の光量が大きくなるように、屈折率および焦点距離が決定されることが好ましい。

【0081】

このような封止構造体20を備える光結合器21は、光結合器21の外部の装置である制御装置と電氣的に接続される。制御装置と光結合器21とは、互いに電気信号を送受信する。

【0082】

光学素子22が、発光素子である場合、制御装置は、発光指令を電気信号として、リードフレーム30の外部接続部36を介して、ドライブ回路32に与える。ドライブ回路32は、与えられる電気信号に従って、発光素子22の発光面41を発光させる。

【0083】

発光面41から出射した光は、厚み方向他方A2に進む。その光は、透光部38の開口37を通過するとともに透過体31を透過する。そして光は、透過体31のレンズ部分42によって集光されて、光ファイバ23の一端面27に入射する。光ファイバ23の一端面27に入射した光は、ファイバ内を進行する。

【0084】

このようにして光結合器21は、発光素子22と光ファイバ23とを光伝達可能に結合し、制御装置から与えられる電気信号を光信号として光ファイバ23に与えることができる。

【0085】

また、光学素子22が、受光素子である場合、ファイバ内を進行する光は、光ファイバ23の一端面27から出射する。その光は、透過体31のレンズ部分42に入射し、レンズ部分42によって集光される。その光は、透過体31を厚み方向一方A1に進む。そして光は、透光部38の開口37を通過し、受光素子22の受光面41に入射する。

【0086】

受光素子22は、受光面41に光が入射すると、入射する光に応じた電気信号を生成し、生成した電気信号をドライブ回路32または制御装置に与える。このようにして光結合器21は、受光素子22と光ファイバ23とを光伝達可能に結合し、受光素子22に与えられる光信号を電気信号として制御装置に与えることができる。

【0087】

なお、透光部38は、光学面41から遠ざかるにつれて内周径が拡径して形成され、その内周面45が高い光反射率を有することが好ましい。言換えると、軸線方向一端部48が軸線方向他端部49に比べて小径となるテーパ形状に形成されることが好ましい。すなわち透光部38の内周面45は、円錐形状の立体の外周面に沿った形状となる。

【0088】

光学素子22として発光素子を使用する場合、発光面41から放射される光の放射角が広い場合には、その光は透光部38の内周面45で反射された後、レンズ部分42によって屈折されて光ファイバ23に入射する。したがって光学素子22として放射角度の広いLED等を用いた場合でも、光学素子22から出射される光を高効率で光ファイバ23に入射させることができる。また、光学素子22として受光素子を使用する場合でも、透過体31に入射する光を透光部38の内周面45で反射することで集光効果を得ることができる。

【0089】

透光部38はエッチングまたはプレス加工などによって、リードフレーム30のパターニング加工と同時に形成することができる。したがって透光部38の内周面をテーパ形状にするために新たな加工工程を必要としない。これによって製造コストを増大させることなく集光効果の高い封止構造体20を製造することができる。

【0090】

このように封止体29は、光路80を除いた領域に配置される。光路80は、上述したように、光学素子22と光ファイバ23とにわたって光が進む領域である。これによって

封止体 29 が有色であっても、透光部 38 の開口 37 を通過する光の光量が低下することなく、封止体 29 として選択可能な材料の選択肢を広げることができる。これによって封止体 29 に光学素子 22 の耐環境性を向上するための有色の添加材を添加しても、光の伝達率が低下することがなく、耐環境性を向上することができる。

【0091】

たとえば封止体がエポキシ樹脂である場合、耐熱衝撃性および放熱性を向上するために、フィラーが添加される。フィラーは、たとえば溶融シリカまたは結晶シリカなどである。また、その他の耐環境性として、耐湿性、耐熱性、耐寒性、高温での安定動作性、低温状態での安定動作性、樹脂強度向上性、難燃性および着色性が挙げられる。その他の耐環境性を向上する物質として、窒化アルミニウム、アルミナ、窒化ボロン、酸化亜鉛および炭化ケイ素などが挙げられ、これらの物質のうちいずれかが添加されてもよい。このような耐環境性を向上する物質が封止体に添加されることによって、光伝達率を低下することなく、封止構造体 20 の耐環境性を向上することができる。

【0092】

また光学素子 22 は、光学素子搭載部 34 にフェースダウン配置状態で配置される。これによって光学面 41 で生じた熱が、光学素子搭載部 34 に伝達しやすく、光学素子 22 の放熱性を改善することができる。これによって光学素子 22 の動作時の温度を低減することができるので、高温環境下においても光学素子 22 を安定して動作させることができ、また、光学素子 22 の熱膨張を抑えて、光学素子 22 に生じる応力を低減することができる。光学素子 22 の損傷を低減することができる。

【0093】

たとえば光学素子 22 として LED を使用する場合、LED の表層の活性層となる光学面 41 で発熱する。光学素子 22 は熱抵抗が大きい。したがって従来のフェースアップ配置、すなわち光学面 41 と反対側の面をリードフレーム 30 に接着する配置状態では、光学面 41 から光学素子搭載部 34 への熱伝達率が低く、放熱特性が悪い。

【0094】

これに対して本発明では、フェースダウン配置で光学素子 22 をリードフレーム 30 に接着することによって、光学素子 22 の内部を伝達せずに光学面 41 からリードフレーム 30 に熱が直接伝わる。これによって光学素子 22 の放熱特性を改善することができる。特に光学素子 22 が砒化ガリウム (GaAs) である場合は熱抵抗が大きいので、光学素子 22 の放熱性を大きく改善することができる。

【0095】

また、フェースダウン配置状態では、光学素子 22 の厚み方向他方 A2 側の表面部 46 は、リードフレーム 30 に接触している。したがって光学面 41 の近傍部分を、封止体 29 で封止する必要がない。これによって光学素子 22 が小型である場合であっても、光学面 41 の近傍部分に封止体 29 を配置する必要がなく、封止構造体 20 を容易に製造することができる。

【0096】

光学素子 22 と光学素子搭載部 34 とが電氣的に接続される場合、光学素子 22 と光学素子搭載部 34 との接合には、導電性を有する接着材料によって、光学素子搭載部 34 に光学素子 22 を接着することが好ましい。これによって光学素子搭載部 34 に対する光学素子 22 の接着と電氣的接続とを 1 つの動作で行うことができる。

【0097】

また、導電性の高い接着剤のなかでも、熱伝導性の高い材料や薄膜の材料を用いることで、熱的なコンタクトが十分得られる。さらに接着剤は、リードフレーム 30 と光学素子 22 との線膨張係数の差を吸収できるようなものがより好ましい。たとえば接着材料は、銀ペーストまたはハンダペーストによって実現することができる。また金共晶接合によって光学素子搭載部 34 に光学素子 22 を接着してもよい。

【0098】

また、透光部 38 の軸線方向他端部 49 を透過体 31 で覆うことによって、光学面 41

が露出することを防ぐことができる。これによって水分や不純物が光学面 41 に付着することを防ぐことができ、封止構造体 20 の耐湿性を向上することができる。また透過体 31 にレンズ部分 42 が形成されることによって、簡単な構成でかつ小型の光学系によって、光利用効率を向上することができる。

【0099】

光学素子 22 としては、LED、PD のほかに、CCD、面発光レーザ (VCSEL、Vertical Cavity Surface Emitting Laser)、およびこれらの光学素子 22 と集積回路 (IC、Integrated Circuit) とを集積化した光学集積回路 (OPIC、Optical Integrated Circuit) などを用いることができる。光学素子 22 の光波長としては、光結合器 21 に結合される光ファイバ 23 の伝送損失が少ない波長であることが好ましい。

【0100】

光ファイバ 23 としては、たとえば、プラスチック光ファイバ (POF: Polymer Optical Fiber) や石英ガラス光ファイバ (GOF: Glass Optical Fiber) などのマルチモード光ファイバを用いることが好ましい。POF は、コアがポリメタクリル酸メチル (PMMA、Poly methyl Methacrylate) やポリカーボネート等の光透過性に優れたプラスチックから成り、クラッドが上記コアよりも屈折率の低いプラスチックで構成されている。POF は、GOF に比べそのコアの径を $200\mu\text{m}$ 以上 1mm 以下と大きくすることが容易である。したがって POF を用いることによって、光結合器 21 との結合調整が容易となるとともに、安価に製造することができる。

【0101】

またコアが石英ガラスから成り、クラッドがポリマーで構成された PCF (Polymer Clad Fiber) を用いても良い。PCF は POF に比べると価格が高いが、伝送損失が小さく、伝送帯域が広いという特徴がある。したがって PCF を伝送媒体とすることによって、長距離の通信およびより高速の通信が可能な光通信網を構成することができる。

【0102】

たとえば、光通信用途の場合に用いられる LED の大きさは、素子サイズが数百 μm 角程度であり、光学面 41 の直径が $100\mu\text{m}$ 程度である。また光通信用途の場合に用いられる PD の大きさは、 1mm 角程度であり、光学面 41 の直径が数百 μm 以上 1mm 以下程度である。ただし、通信速度等により光学面 41 のサイズは異なる場合がある。

【0103】

リードフレーム 30 の厚さは、 $100\mu\text{m}$ 以上 $500\mu\text{m}$ 以下である。リードフレーム 30 としては、導電性を有し、かつ熱伝導性の高い金属から成る薄板状の金属板が用いられる。たとえばリードフレーム 30 は、銅やその合金、鉄の合金、たとえば鉄にニッケルが約 42 パーセント含まれる 42 アロイ等が用いられる。リードフレーム 30 は、透光部 38 の内周面 45 の光反射率を高くするために、銀または金によるメッキ処理を施してもよい。

【0104】

上述したように透光部 38 の内周面 45 は、円錐台形状の立体の外周面に沿った形状となる。透光部 38 の軸線方向一端部 48 の内径直径である小径側直径は、光学素子 22 の光学面 41 の大きさに合わせて設定される。小径側直径 L2 が小さくなりすぎると、光学素子 22 の配置がずれた場合、光学素子 22 の光学面 41 の一部が遮蔽されて光の利用効率が減少してしまうため、高精度で光学素子 22 を配置しなければならないという問題があり、小径直径 L2 が大きくなりすぎると、透光部 38 の内周面 45 で反射された光が、すでに広がった状態で反射されるため、光ファイバ 23 に集光させることが困難となり、光学素子 22 の光学素子搭載部 34 への接着面積が減少して接着強度が不足したりするという問題がある。

【0105】

したがって、小径側直径 L2 は、光学素子 22 の光学面 41 の直径に、予め定められる配置精度に起因する最大ずれ量を加算した値に設定される。たとえば、光学面 41 の直径が $100\mu\text{m}$ で、配置精度が $\pm 20\mu\text{m}$ であった場合、小径側直径 L2 は $120\mu\text{m}$ に決

定される。本実施の形態では、小径側直径 L_2 が、光学面41の1.1倍以上1.6倍以下に設定されることによって、上述した問題を解消することができる。

【0106】

また透光部38の軸線方向他端部49の内径直径である大径側直径 L_3 は、透光部38の内周面45の傾斜角度によって決定される。光学素子22が発光素子である場合、透光部38の内周面38は、内周面45で反射された光が、光ファイバ23の光軸に対して平行に近くなる角度に設定される。この内周面45の傾斜角度は、小さすぎても大きすぎても、透光部38から出射する光が拡散してしまう。具体的には、光軸を含む仮想線で封止構造体を切断した場合に、リードフレーム30の厚み方向一方A1側表面と内周面45との成す角度は、30度以上でかつ70度以下に設定することが好ましい。

【0107】

また光学素子22が受光素子である場合、透光部38の内周面38は、内周面45で反射された光が、受光素子の光学面41の光学面に集光する角度に設定される。この内周面45の傾斜角度は、小さすぎても大きすぎても、光学面41へ集光される光の光量が減少してしまう。具体的には、光軸を含む仮想線で封止構造体を切断した場合に、リードフレーム30の厚み方向一方A1側表面と内周面45との成す角度は、30度以上でかつ70度以下に設定することが好ましい。

【0108】

図3は、封止構造体20の製造手順を示すフローチャートであり、図4は、封止構造体20の製造手順を示す図である。まず、ステップs0で、封止構造体20の外形設計およびリードフレーム30の配線パターン設計などの設計工程が完了すると、ステップs1に進み、封止構造体20の製造を開始する。

【0109】

ステップs1では、ステップs0で設計される配線パターンに従って、リードフレーム30を形成する。リードフレーム30は、エッチングまたはプレス加工によって形成される。これによってリードフレーム30に、光学素子搭載部34、内部接続部35および外部接続部36などを形成する。このとき、光学素子搭載部34には、厚み方向Aに貫通する透光部38を有する。このように透光部38を有するリードフレーム30を形成すると、ステップs2に進む。

【0110】

ステップs2では、リードフレーム30に搭載されるべき被搭載体22、32を、リードフレーム30に接着する。具体的には、光学素子22を光学素子搭載部34にダイボンドする。またドライブ回路32を対応する内部接続部35bにダイボンドする。このとき光学面41が、光学素子搭載部34の開口37に厚み方向一方A1側から臨むように配置する。また透光部38の軸線方向一端部48を塞ぐように、光学素子22を光学素子搭載部34に接着する。

【0111】

光学素子22を光学素子搭載部34に配置するにあたって、導電性を有する接着材料によって光学素子搭載部34に光学素子22を接着する。これによって、光学素子22のうち厚み方向一方A2に形成される電極端子53は、光学素子搭載部34に形成される電極端子53に電氣的に接続される。

【0112】

次にワイヤ33によって各被搭載体22、32を電氣的に接続する。具体的には、光学素子22のうち厚み方向他方A2側に形成される電極端子50と、ドライブ回路32のうち厚み方向他方A2に形成される電極端子51とを、第1ワイヤ33aによってワイヤボンドする。また光学素子搭載部34に形成される電極端子53と、予め定められる内側接続部35とを、第2ワイヤ33bによってワイヤボンドする。このようにして図4(1)に示すように、各被搭載体22、32、22をリードフレーム30に搭載すると、ステップs3に進む。

【0113】

ステップs3では、封止用モールド樹脂を用いて封止体29をモールド成形する。まず、被搭載体22、32を搭載したリードフレーム30を封止体成形用金型60に装着する。封止体成形用金型60は、リードフレーム30が装着した状態で、リードフレーム30よりも厚み方向一方A1に内部空間が形成される。封止体成形用金型60のうちリードフレーム30に関して厚み方向他方A2側となる第1の金型部分61は、リードフレーム30の厚み方向他方A2側の表面部全面に当接する。また封止体成形用金型60のうちリードフレーム30に関して厚み方向一方A1側となる第2の金型部分62は、ドライブ回路32、光学素子22およびワイヤ33a、33bから厚み方向一方A1に退避し、それらに接触することがない。

【0114】

次に、図4(2)に示すように、封止体成形用金型60の内部空間に封止用モールド樹脂を注入し、封止用モールド樹脂によって封止体29を成形する。この封止用モールド樹脂は、耐環境性を向上する添加剤が含有されている。このようにして封止体29を成形して形成すると、ステップs4に進む。

【0115】

ステップs4では、透過用モールド樹脂を用いて透過体30をモールド成形する。まず、封止体29が成形されたリードフレーム30を透過体成形用金型63に装着する。透過体成形用金型63は、リードフレーム30が装着した状態で、リードフレーム30よりも厚み方向他方A2に内部空間が形成される。透過体成形用金型63のうち、リードフレーム30に関して厚み方向他方側A2となる第3の金型部分64は、少なくともリードフレーム30の透光部38から退避し、透光部38を塞ぐことがない。本実施の形態では、透過体31にレンズ部分を成形するために、第3の金型部分64とリードフレーム30との間の厚み方向Aの距離L4は、透光部38の中心軸線から遠ざかるにつれて小さくなる。また透過体成形用金型63のうち、リードフレーム30に関して厚み方向一方側A1となる第4の金型部分65は、成形された封止体29を収容可能な内部空間が形成される。

【0116】

次に、図4(3)に示すように、透過体成形用金型63の内部空間であって、第3の金型部分64とリードフレーム30との間に透過用モールド樹脂を注入し、透過用モールド樹脂によって透過体31を成形する。これによって透光部38の開口37にも、透過用モールド樹脂を注入する。このようなモールド樹脂は、成形後の光透過率が高いものが好ましい。このようにして透過体31を成形して形成すると、ステップs5に進む。ステップs5では、各モールド樹脂のバリとりなどの後処理を行った後、ステップs6に進み、封止構造体20の製造を完了する。

【0117】

以上のように、モールド樹脂を用いて封止体29および透過体30を形成することで、封止構造体20を安価にかつ容易に形成することができる。特にトランスファ成形を行うことによって、封止構造体20の大量生産が可能となる。本実施の形態では、光学素子22によってリードフレーム30の透光部38の軸線方向一端部48を塞いだ後で、封止体29をモールド成形する。これによって封止用モールド樹脂が光学面41および光路80に浸入することを容易に防ぐことができる。

【0118】

なお、封止体成形工程において、リードフレーム30の変形および金型の寸法誤差などが生じることで、リードフレーム30から厚み方向他方A2側に封止用モールド樹脂が回り込むことを完全に押さえることができない。この場合、リードフレーム30の厚み方向他方A2側の一部に封止用モールド樹脂が回り込む現象、いわゆるフラッシュが生じる場合がある。

【0119】

本実施の形態では、図1に示すように、光学素子搭載部34は、その縁辺部44から透光部38まで予め定める離間距離L1だけ離間して形成される。これによって、フラッシュが生じて透光部38には封止用モールド樹脂が回り込まないようにすることが可能で

ある。したがって金型 60 およびリードフレーム 30 の高精度の管理を必要せずに、封止用モールド樹脂が光路 80 を塞ぐことを防ぐことができる。

【 0 1 2 0 】

【0120】
離間距離L1は、封止用モールド樹脂が透光部38に浸入しない十分な長さに設定される。封止体29および透過体31の厚み方向寸法が、1mm程度に形成される場合、離間距離L1は、数百 μm 以上数mm以下に設定されることが好ましく、たとえば200 μm 以上3mm以下に設定される。離間距離L1が数百 μm 未満である場合には、封止用モールド樹脂が透光部38に達してしまう。また離間距離L1が数百 μm を超える場合には、封止構造体20の小型化が困難になるという問題がある。

【0 1 2 1】

【0121】
このように縁辺部44から透光部38までの距離L1が離間距離L1に設定されること
によって、光学素子搭載部34によって、フラッシュによる光路の遮蔽を簡単に防止する
ことが可能である。したがって、LEDやPDなどのサイズが小さい光学素子22を使用
しても、封止体29を簡易に成形することができる。

【0 1 2 2】

【0122】
また、封止体成形工程において、金型と各被搭載体22、32、33とが離反して設けられる。これによって光学素子22およびワイヤ33に金型が接触するおそれを少なくすることができる。したがって光学素子22が破損することを防いで、不良品を低減することができる。また金型の精度管理およびリードフレーム30の変形防止を厳密に行わなくてもよい。したがって光学素子22が小型であっても、安易な製造方法を用いて封止構造体20を製造することができる。

【 0 1 2 3 】

【０１２３】
また本実施の形態では、封止体成形工程において、リードフレーム３０の厚み方向他方Ａ２側の表面部全面を第１の金型部分６１の内面に接触させた状態で、金型内部空間へ封止用モールド樹脂を注入する。これによって第１の金型部分６１を複雑な形状にする必要がない。また封止用モールド樹脂が透光部３８および光路８０に達することを確実に防止することができる。

【0124】

【0124】
また透過体31は、高い光透過率を得るために封止体29よりも耐熱温度が低い場合がある。本実施の形態では、封止体成形工程の後に透過体成形工程を行うことによって、透過用モールド樹脂が過剰に加熱されることがなく、透過体31の成形精度を向上することができる。これによって透過体31に形成されるレンズ部分42を精度よく形成することができ、集光効率を向上することができる。

【 0 1 2 5 】

【0125】
また、封止用モールド樹脂に耐環境性を向上する添加剤を添加するだけで、封止構造体20の耐環境性を向上することができる。また耐環境性を向上したうえで、透光部38を通過する光量の低下を防ぎ、光の伝達率が低下することがない。言換えると耐環境性の向上と光の伝達率の維持とを両立することができ、封止構造体20の品質を向上することができる。

【 0 1 2 6 】

【0126】
たとえば、封止体29の線膨張係数を、各被搭載体22、32、33のいずれかの線膨張係数に近づけることによって、各被搭載体22、32、33の熱衝撃性を向上することができる。これによって被搭載体22、32、33の破損を防ぐことができ、封止構造体の信頼性を向上することができる。また封止体29の熱抵抗を低下することによって、封止構造体20の熱伝達率を高くして放熱性を向上することができる。

【 0 1 2 7 】

【0127】
光学素子22としてLEDを用いる場合、透光部38の開口37に、屈折率が空気よりも高い透過用モールド樹脂を注入し、透過用モールド樹脂が発光面41に接触した状態で成形することが好ましい。これによってLEDの外部量子効率を改善することができ、発光量を向上することができる。外部量子効率は、LEDに流れる電流に対して、LEDか

ら出射される出力電子数である。

【0128】

なお、透光部 38 を形成するにあたって、光学素子 22 やレンズ部分 42、光ファイバ 23 を位置合せするための基準孔（図示せず）をあわせて形成することが好ましい。このような基準孔を光結合器 21 の組み立て基準とし、透光部 38、光学素子 22、レンズ部分 42 を位置合せすることによって、高精度な組み立てを行うことができる。さらに封止構造体 20 が光結合器 21 に用いられる場合、前記基準孔を、光ファイバ 23 と光学素子 22 との位置合せの基準とすることができる。

【0129】

また、光学素子 22 のダイボンドにあたって、光学素子 22 とリードフレーム 30 とを接着する接着剤は、光学素子 22 の光学面 41 に付着しないようにする必要がある。フォトリソグラフィ等の手法によって、光学素子 22 の表面のうち、光学面 41 以外の部分に接着剤の薄膜を予め形成する。これによって接着剤が光学面 41 に付着しないようにすることができる。

【0130】

封止体 29 に用いられる封止用モールド樹脂は、半導体素子の封止に使用されているエポキシ樹脂などにフィラーを添加した材料が使用される。封止用モールド樹脂は、上述したように、光学素子 22 またはワイヤ 33 の少なくともいずれかと線膨張係数が近く、熱伝導性の高くなるように設定される。たとえば光学素子 22 は、シリコン (Si) またはガリウム砒素 (GaAs) から成り、ワイヤ 33 は金 (Au) またはアルミ (Al) から成る。

【0131】

光学素子 22 の線膨張係数が、 $2.8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ であり、ワイヤ 33 の線膨張係数が、 $14.2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ である場合、封止用モールド樹脂の線膨張係数は、 $20 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ 以下に設定することが好ましい。なお、フィラーを添加していないエポキシ樹脂の線膨張係数は、 $60 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ 程度である。また、封止用モールド樹脂の熱伝導率は、 $0.6 \text{ W} / ^\circ\text{C}$ 以上に設定することが好ましい。なお、フィラーを添加していないエポキシ樹脂の熱伝導率は、 $0.2 \text{ W} / ^\circ\text{C}$ 程度である。これによって温度変化によって、光学素子 22 およびワイヤ 33 に生じる応力を低減することができる。また放熱性を向上することができる。

【0132】

透過体 31 に用いられる透過用モールド樹脂は、光学的に透明であるエポキシ樹脂等が使用される。透過用モールド樹脂は、フィラーが添加されていない、もしくは少量のフィラーが添加されているエポキシ樹脂が使用される。

【0133】

ここで、光学的に透明とは、使用される波長領域の光を透過可能な透過性を有するという意味であり、その光透過率は 70% 以上であることが好ましい。透過用モールド樹脂はリードフレーム 30 の厚み方向他方 A2 側の表面を覆うように形成される。

【0134】

図 5 は、封止体成形後の状態を示す平面図である。なお、図 5 には、透過体成形位置を 2 点差線で示す。封止用モールド樹脂によって封止体 29 を成形した後、封止体成形用金型 60 からリードフレーム 30 を取外す場合に、封止体用成形金型 60 と封止体 29 とを離型性を高めるために、封止用モールド樹脂には離型剤が添加される。この場合、封止体成形後には、封止体 29 の表面に離型剤がしみ出た状態となる。

【0135】

離型剤が封止体 29 の表面にしみ出すと、透過体 31 と封止体 29 との密着性が低下してしまう。本実施の形態では、図 5 に示すように、透過体 31 がリードフレーム 30 に接触する第 1 接触面積が、透過体 31 が封止体 29 に接触する第 2 接触面積よりも大きく設定される。なお、図 5 に第 1 接触面積を破線 70 のハッチングの領域で示し、第 2 接触面積を実線 71 のハッチングの領域で示す。第 1 接触面積が第 2 接触面積よりも大きく形成

されることで、透過体 31 の密着性を向上することができる。これによって温度変化および外力などに起因して、透過体 31 が、リードフレーム 30 および封止体 29 からはく離することを防ぐことができる。またはく離に起因して水分が封止構造体内に浸入することを防止することができ、耐湿性を向上することができる。

【0136】

また、透過体 31 はその外周部において応力が大きくなるので、透過体 31 の外周部全てまたは一部がリードフレーム 30 に接するように設定することが好ましい。たとえば厚み方向 A に垂直な仮想切断面に沿って透過体 31 を切断した場合に、その切断面が長方形に形成される場合には、透過体 31 の短辺側の端部をリードフレーム 30 と直接接するように設定することが好ましい。図 5 には、短辺側端部が当接するリードフレーム 30 の当接部分を参照符号 72 で示す。

【0137】

以上のように、モールド成形を用いて製造した封止構造体 20 は、ガラスレンズを使用した封止構造体と比較すると安価で作製が容易である。また、封止構造体 20 は、PD や LED のようにサイズの小さい光学素子 22 を用いた場合でも、耐環境性に優れた封止用モールド樹脂を用いるという簡易な成形工程によって、光学素子 22 およびワイヤ 33 の封止が可能となり、安価で耐環境性に優れた封止構造体 20 を製造することができる。また、光結合器 21 が、本実施の形態の封止構造体 20 を備えることによって、同様の効果を得ることができる。

【0138】

図 6 は、本発明の実施の第 2 形態である封止構造体 120 を示す断面図であり、図 7 は、封止構造体 120 を備える光結合器 121 を示す断面図である。第 2 形態の封止構造体 120 は、第 1 形態の封止構造体 20 に対して、透過体の形状と、リードフレームにおける光学素子搭載部 34 の構成とが異なり、他の構成については、第 1 形態の封止構造体 20 と同様の構成を有する。したがって第 1 形態の封止構造体 20 の構成に相当する第 2 の封止構造体 120 の構成については、第 1 形態の封止構造体 20 と同一の参照符号を付し、説明を省略する。

【0139】

封止構造体 120 は、リードフレーム 30 の光学素子搭載部 34 の厚み方向一方 A1 側に中間体であるサブマウント 100 が固定される。そしてサブマウント 100 の厚み方向一方 A1 側に光学素子 34 が接着される。すなわち封止構造体 120 は、透光部 38 と光学素子 22 との間にサブマウント 100 が介在される。本実施形態では、リードフレーム 30 の光学素子搭載部 34 とサブマウント 100 とを含んで、光学素子 22 を厚み方向一方 A1 側に搭載する搭載体となる。

【0140】

光学素子搭載部 34 は、厚み方向 A に貫通する開口 37 を形成する透光部 38 を有する。光学素子搭載部 34 は、厚み方向一方 A1 側の表面部にサブマウント 100 が接着される。この場合、サブマウント 100 は、透光部 38 の軸線方向一端部 48 を塞ぐ。サブマウント 100 は、透光部 38 に対向する位置に光通過部 101 が形成される。光通過部 101 は、光がサブマウント 100 を貫通可能に形成される。本実施の形態では、光通過部 101 には、厚み方向に貫通した開口 104 が形成される。なお、透光部 38 に形成される開口 37 と、光通過部 101 に形成される開口 104 は、同軸に形成される。

【0141】

サブマウント 100 は、厚み方向一方 A1 側の表面部に光学素子 22 が接着される。この場合、光学素子 22 は、光通過部 101 の軸線方向一端部 102 を塞ぐ。光学素子 22 は、光学面 41 が、透光部 38 に形成される開口 37 および光通過部 101 に形成される開口 104 を通過する光の光路 80 の延長線上に配置される。言換えると、光学素子搭載部 34 およびサブマウント 100 は、光学面 41 と対向する位置に開口 37、104 がそれぞれ形成される。透光部 38 によって形成される開口 37 は、サブマウント 100 の光通過部 101 によって形成される開口 104 より大きく形成される。

【0142】

封止体29は、図1に示す封止構造体20と同様に、封止体29は、光学素子22およびドライバ回路32に関して、リードフレーム30の反対側から、光学素子22およびドライバ回路32を覆う。したがって封止体29は、光学素子22の厚み方向一方A1側部分を塞ぎ、封止体29のうち厚み方向他方A2側で光学素子22を覆う。封止体29は、少なくとも光路80を除く領域に形成される。

【0143】

サブマウント100には光学素子22の電極と電気的に結合する電極を形成し、ワイヤ33によってリードフレーム30およびドライバ回路32に電気的に接続させてもよい。この場合、光学素子22およびドライバ回路32の電極端子とサブマウント100とは、電気的に導通した状態で接着される。なお、リードフレーム30とサブマウント100とは必ずしも電気的に結合させる必要はなく、任意の接着剤によって接着されてもよい。

【0144】

サブマウント100は、シリコン基板およびガラス基板などによって形成される。たとえば、サブマウント100として単結晶シリコン基板を用いる場合、シリコン基板を異方性エッチングすることによって断面が四角形状の開口を、光通過部101に形成することができる。具体的には、単結晶シリコンのミラー指数(100)で表わされる結晶面に水酸化カリウム(KOH)水溶液を滴下してエッチングすることによって、ミラー指数(111)面で表わされる結晶面が露出する。四角形のマスクを用いてエッチングすることで、形成される透光部38の内周面45は、四角錐形状の立体の外周面に沿った形状となる。この場合、透光部38の内周面45は、(100)で表わされていた結晶面に対して、54.74°の角度を有する4つの平滑面を有する。

【0145】

このようにして、サブマウント100の光通過部101を形成する場合には、リードフレーム30の透光部38をテーパ状に加工する場合に比べて、加工精度や面精度が高い。これによって光通過部101の内周面について、反射ミラーとしての高い性能を得ることができる。また、シリコンは熱伝導性が高いので、サブマウント100をシリコンで形成することによって、光学素子22に発生する熱を奪い、光学素子22の温度上昇を抑えることができる。さらに光学素子22がシリコンによって実現される場合には、サブマウント100と光学素子22との線膨張係数の差が少なく、光学素子22に生じる応力を低減することができる。

【0146】

また、サブマウント100としてガラス基板を用いても良い。ガラス基板は光学的に透明であるため、サブマウント100の光通過部101に開口104を別途形成する必要がない。また、光学素子22と線膨張係数が近いガラスを用いて、サブマウント100を形成することによって、光学素子22への応力を低減することができる。光学素子22と線膨張係数が近いガラスとして、たとえばパイレックス(登録商標)ガラスがある。また光通過部101に凸レンズやフレネルレンズを形成して、光路80を通過する光を集光する集光部分を形成してもよい。これによって、簡単な構成でかつ小型の光学系によって、封止構造体20の光利用効率を向上することができる。

【0147】

またサブマウント100の光通過部101が、光学的に透明な材料で形成されることによって、光学素子22の発光面41側の表面と対向させることができる。この場合、透過体によるリードフレーム30の透光部30の封止を行う必要がない。ただし、透過体によって透光部30の封止を行ってもよい。さらに任意の形状のレンズを直接透光部38に対向する位置に貼り付けてもよい。

【0148】

また、光学素子22としてPDを用いる場合、光学面41の近傍にリードフレーム30などの導電性材料を対向させると、PDの寄生容量が増加して、高速駆動が困難になるという課題がある。本実施の形態では絶縁性を有するサブマウント100を、リードフ

ム 20 と光学素子 22 との間に介在させることによって、リードフレーム 4 とのギャップが広がる。これによって PD の寄生容量を低減することが可能となる。さらにサブマウント 100 に形成され、光学素子 22 の電極と接続する対向電極の面積を小さくすることによって、PD の寄生容量をさらに低減することが可能となる。また、サブマウント 100 に任意の電極パターンを形成することによって、光学素子 22 として OPIC (PD およびアンプ等の回路を含んだ集積回路) を使用することが容易となる。

【0149】

また図 6 に示す封止構造体 120 の透過体 131 は、光ファイバ 23 の一端部に固定されるプラグ 25 が嵌合する嵌合部 90 が形成される。嵌合部 90 は、プラグ 25 の一端部が着脱可能に形成される。嵌合部 90 は、プラグ 25 の外周面に当接し、プラグ 25 が厚み方向 A に垂直な方向に移動することを阻止する。また透過体 131 は、嵌合部 90 から、光路に向かって突出する突出部 91 が形成される。突出部 91 は、光ファイバ 23 の一端部に当接することなく、プラグ 25 の一端面に当接する。突出部 91 は、プラグ 25 の厚み方向一方 A1 への移動を阻止し、光ファイバ 23 がレンズ部分 42 に接触することを防ぐ。

【0150】

嵌合部 90 にプラグ 25 が嵌合した状態で、光ファイバ 23 の一端部と、光学素子 22 とが厚み方向に一直線に並ぶ。これによって光ファイバ 23 を嵌合部 90 に吻合するだけで、光ファイバ 23 を光学素子 22 に対向する位置に案内することができ、利便性を向上することができる。

【0151】

また嵌合部 90 にプラグ 25 が嵌合した状態で、光ファイバ 23 の一端部と透過体 131 のレンズ部分 42 とは、予め定めるギャップ L4 を開けて設けられる。これによって光ファイバ 23 と透過体 131 のレンズ部分 42 とが衝突することを防ぐことができ、封止構造体 131 および光ファイバ 23 の損傷を防止することができる。なお、第 2 形態の封止構造体 120 は、第 1 形態の封止構造体 20 と同様の効果を得ることができる。

【0152】

図 8 は、本発明の実施の第 3 形態である封止構造体 220 を示す断面図である。第 3 形態の封止構造体 220 は、第 2 形態の封止構造体 120 に対して透過体 131 を除いた構成を有する。したがって第 2 形態の封止構造体 220 と同様の構成については、同一の参照符号を付し、説明を省略する。

【0153】

封止構造体 220 は、光学搭載部 34 に光学素子 22 が、サブマウント 100 を介して接続される。透過体 131 を有しない構成であっても、封止構造体 220 の耐環境性を向上するとともに、モールド成形によって製造することができる。これによって光学素子 22 が小型である場合であっても、容易に封止構造体 220 を製造することができる。なお、透過体を形成していないので、製造工程を減らすことができ、さらに安価に製造することができる。なお、第 3 形態の封止構造体 220 は、第 1 形態の封止構造体 20 とほぼ同様の効果を得ることができる。また図 8 には、サブマウント 100 を介して、光学素子 22 をリードフレーム 30 に接着したが、光学素子 22 を直接リードフレーム 30 に接着してもよい。

【0154】

図 9 は、本発明の実施の第 4 形態である封止構造体 320 を示す断面図である。第 4 形態の封止構造体 320 は、第 1 形態の封止構造体 20 に対して、透過体の形状が異なり、他の構成については、第 1 形態の封止構造体 20 と同様の構成を有する。したがって第 1 形態の封止構造体 20 の構成に相当する第 4 の封止構造体 320 の構成については、第 1 形態の封止構造体 20 と同一の参照符号を付し、説明を省略する。

【0155】

第 4 形態の封止構造体 320 は、前述したように、リードフレーム 30 の厚み方向一方 A1 側の表面部、光学素子 22、ワイヤ 33 は封止体 29 によって覆われる。封止構造体

320は、これをさらに透過体131で覆った構成となっている。すなわち、透過体331が、封止体29およびリードフレーム30の外部接続部36以外を透過体331で覆う。透過体131はエポキシ樹脂等の光透過性に優れた樹脂材料からなり、この樹脂によりレンズ部分42が形成されている。モールド成形によって、封止体29および透過体131を形成すると、封止体29と透過体131とは密着性が悪くなる。しかしながら透過体131によって、封止体29を覆うことで、透過体131が封止体29から剥離することを防止することができる。また、第4形態の封止構造体320は、第1形態の封止構造体20と同様の効果を得ることができる。

【0156】

図10は、本発明の実施の第5形態である封止構造体420を示す断面図である。第5の封止構造体420は、第3形態の封止構造体220に対して、封止体429の構成が異なり、その他は同一の構成を有する。したがって第3野形態の封止構造体220と同様の構成については、同一の参照符号を付し、説明を省略する。

【0157】

封止構造体420の封止体429は、リードフレーム30の厚み方向両側を覆う。ただし封止体429は、光路80を除く領域に配置される。すなわち、封止体429は、透光部38の軸線方向他端部をのぞく、リードフレーム4の厚み方向他方側の表面も覆う。外5形態の実施形態の封止構造体420は、封止体429によってリードフレーム30を両側から挟んでおり、リードフレーム30と封止体429との密着性を改善することが可能となる。また、第2の実施形態の封止構造体120のように、リードフレーム30の厚み方向他方A2側に形成される封止体429の一部を、光ファイバ23との位置合せに用いることもできる。

【0158】

第5の実施形態の封止体構造420は、モールド成形によって形成することができる。この場合、封止体成形用金型60のうち、装着するリードフレーム30に関して、厚み方向他方A2側となる第1の金型61によって、リードフレーム30と第2の金型との間に内部空間を形成する。この状態で、封止用モールド樹脂を金型の内部空間に注入することによって、封止体29を成形する。このとき、リードフレーム30の光学素子搭載部34に第1の金型部分61を当接させ、その金型部分61の当接部分の外周部から透光部38までの距離が、前記離間距離L1に設定される。これによって、封止用モールド樹脂が透光部38に回り込むことを防ぐことができる。また光学素子22と第1の金型部分61とは当接することがないので、光学素子22の破損を防止することができる。また封止用モールド樹脂が透光部38に回り込むことを防止すれば、他の部分には形成しても光学的に問題とはならない。

【0159】

なお、上述した実施の各形態の封止構造体は、本発明の一例示に過ぎず、発明の範囲内でその構成を変更することができる。たとえば封止構造体20, 120, 220, 320, 420は、光結合器21に用いられるとしたが、他の装置に用いられてもよい。また光学素子22は、上述に例示した素子以外であってもよい。またモールド成形によって形成されることが好ましいが、他の製造方法によって封止構造体が製造されてもよい。また封止体29は、光学素子22の全体を覆う必要がない。

【0160】

また、リードフレーム30とは、光学素子22およびドライバ回路32などの被搭載体を搭載して支えるとともに、各被搭載体へ電気を伝える役割を果たす薄板状の金属板を意味する。本発明では、リードフレーム30の代わりに、たとえば、ステムやプリント基板等の各種の基板を用いて、光学素子22を搭載して封止構造体20を製造することもできる。透光部38は、開口37が形成されるとしたが、光通過可能な透光性を有すればよい。またレンズ部分42は、凸レンズに形成されるが、凹レンズなどの他の形状に形成されてもよい。

【図面の簡単な説明】

【0161】

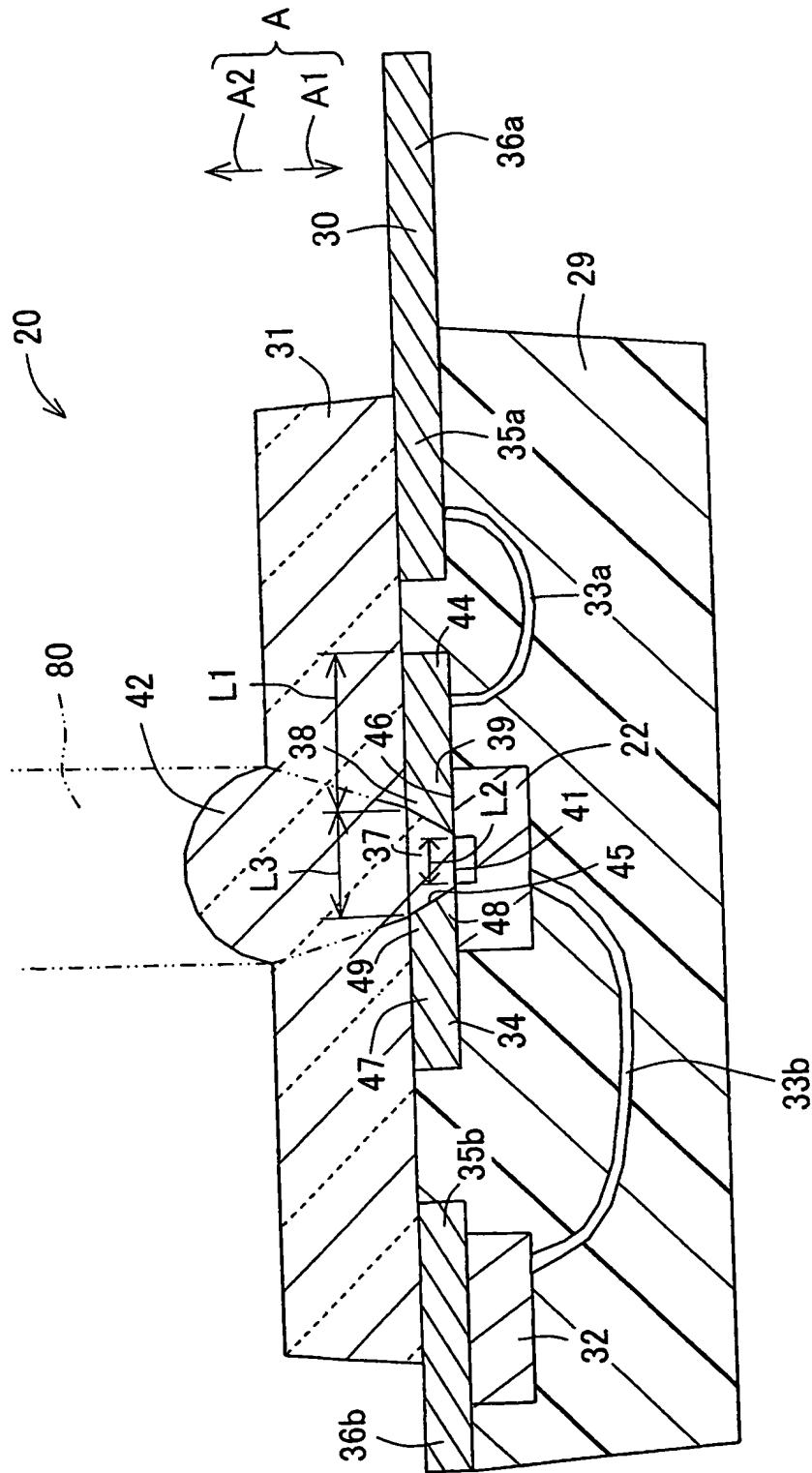
- 【図1】本発明の実施の第1形態である封止構造体20を示す断面図である。
【図2】封止構造体20を備える光結合器21を示す断面図である。
【図3】封止構造体20の製造手順を示すフローチャートである。
【図4】封止構造体20の製造手順を示す図である。
【図5】封止体成形後の状態を示す平面図である。
【図6】本発明の実施の第2形態である封止構造体120を示す断面図である。
【図7】封止構造体120を備える光結合器121を示す断面図である。
【図8】本発明の実施の第3形態である封止構造体220を示す断面図である。
【図9】本発明の実施の第4形態である封止構造体320を示す断面図である。
【図10】本発明の実施の第5形態である封止構造体420を示す断面図である。
【図11】第1の従来技術の封止構造体1を示す断面図である。
【図12】第2の従来技術の封止構造体10を示す断面図である。
【図13】光学素子2が搭載されたリードフレーム3を金型に装着した状態を示す。

【符号の説明】

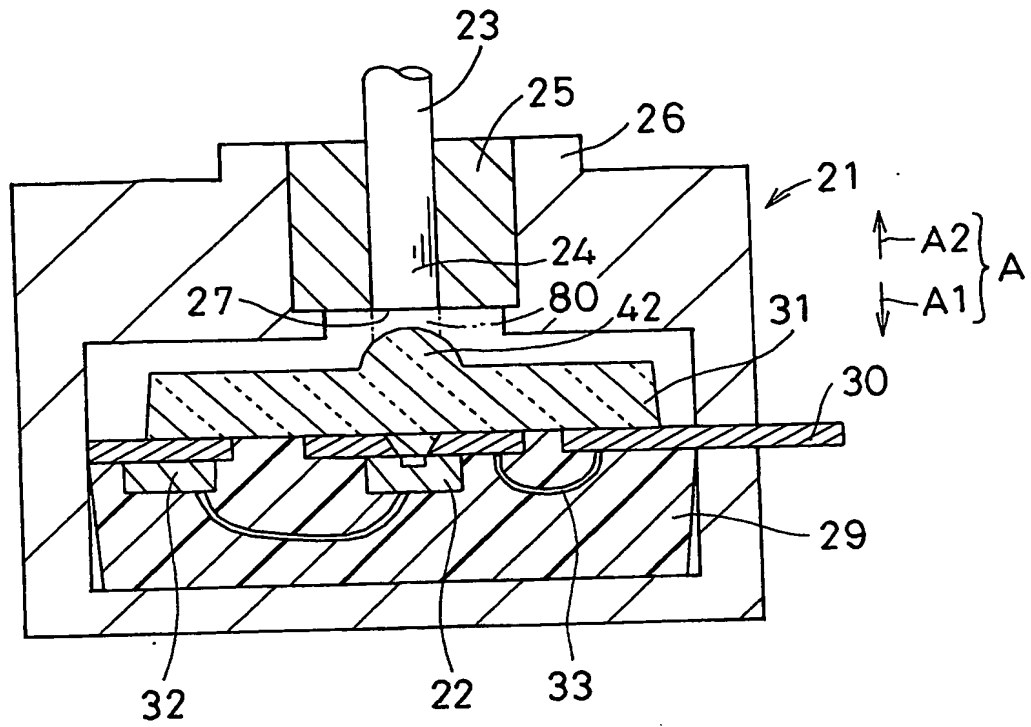
【0162】

- 20, 120, 220, 320, 420 封止構造体
21 光結合器
22 光学素子
29 透過体
30 リードフレーム
31 封止体
33 ワイヤ
34 光学素子搭載部
35 内部接続部
38 透光部
41 光学面
42 レンズ部分
80 光路
100 サブマウント
A 厚み方向

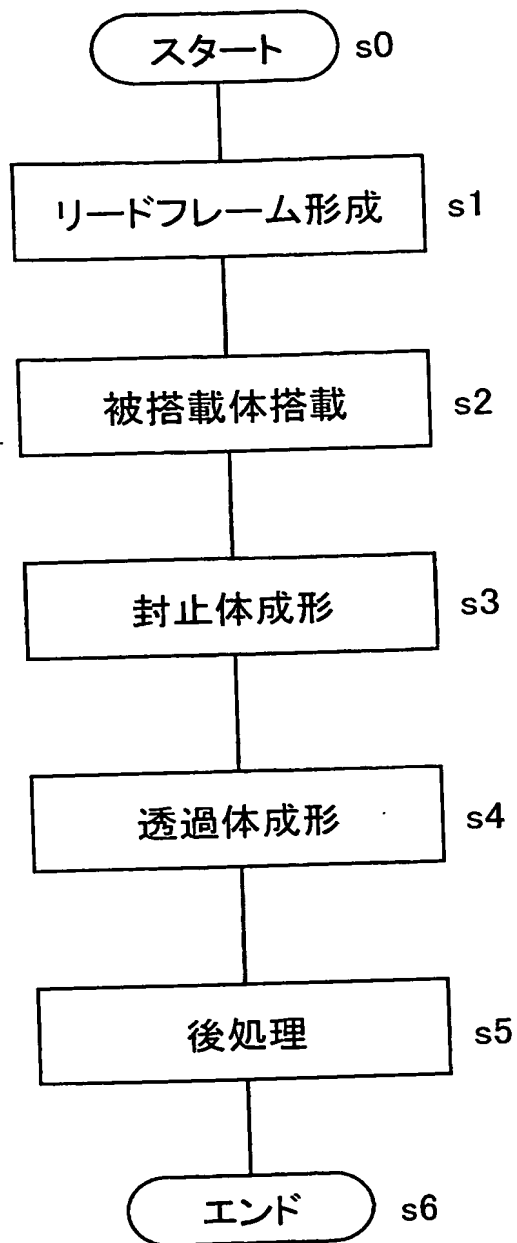
【書類名】 図面
【図 1】



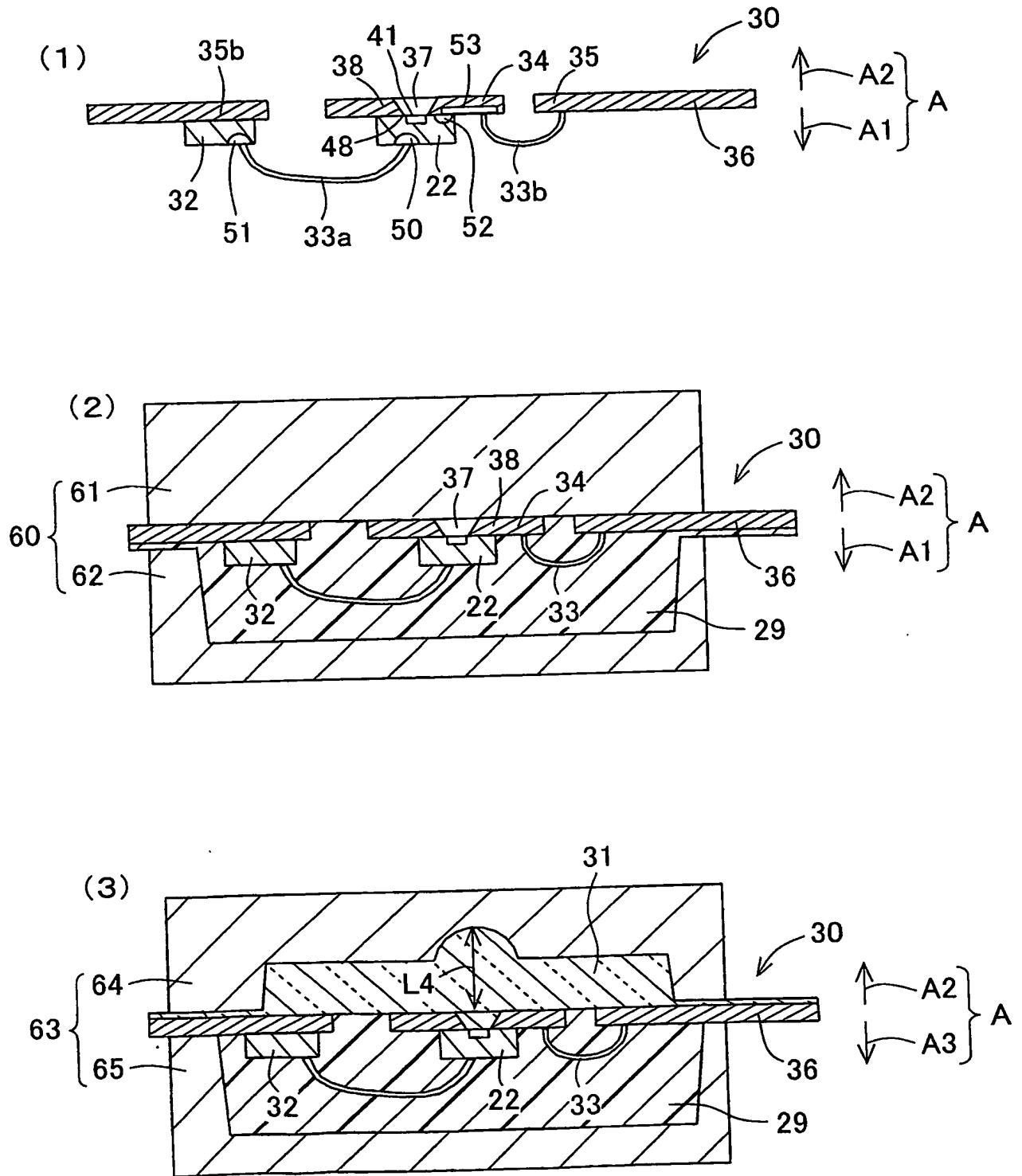
【図 2】



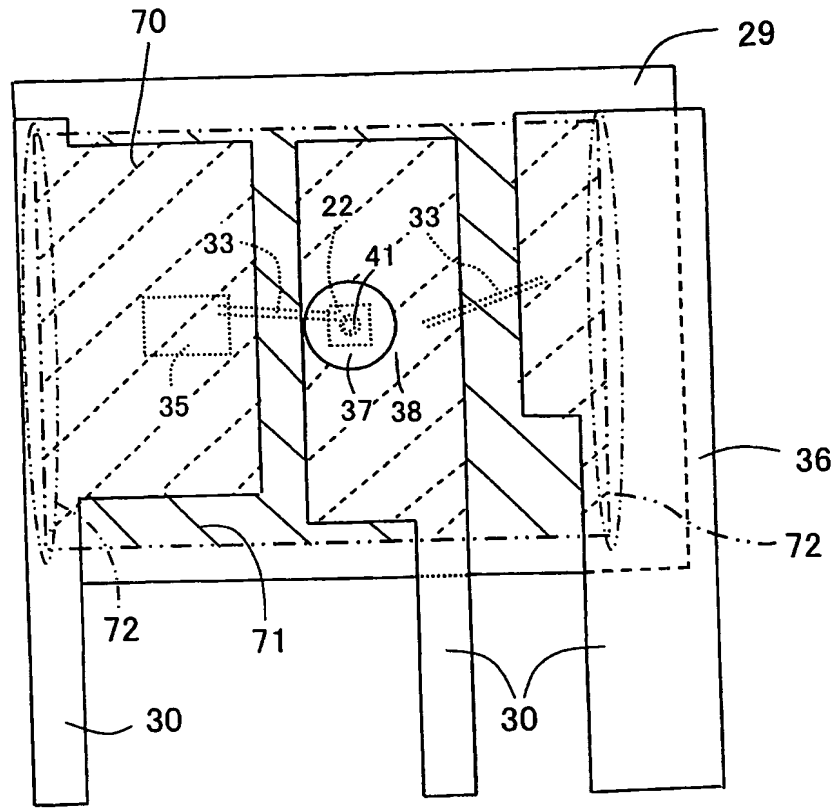
【図 3】



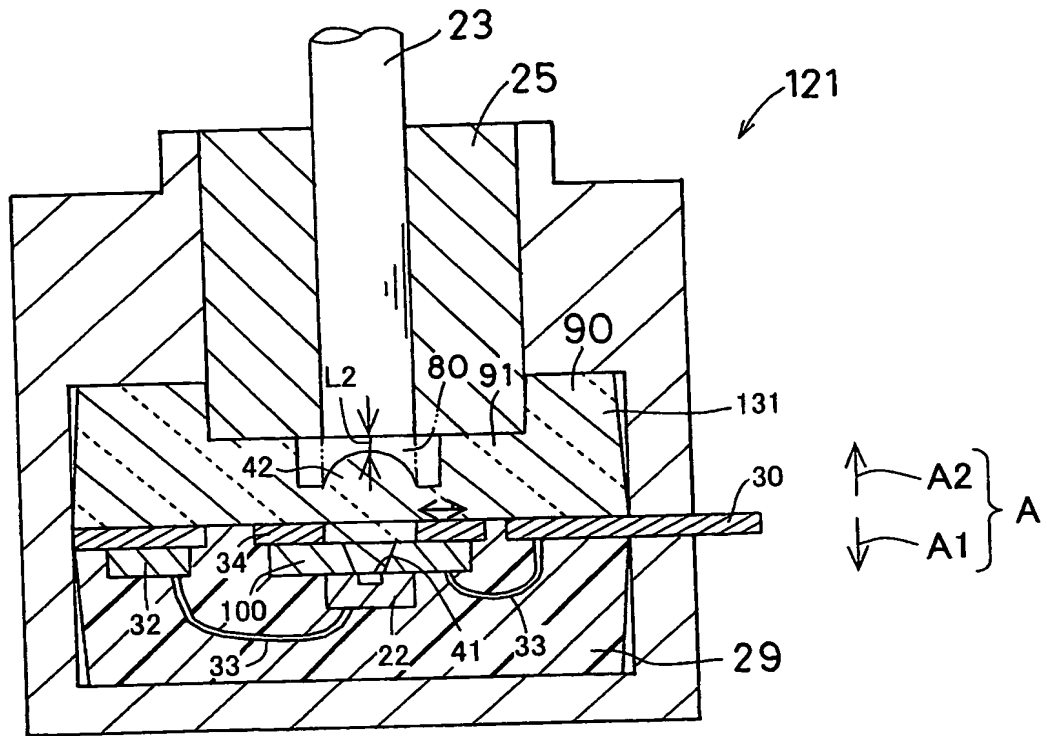
【図 4】



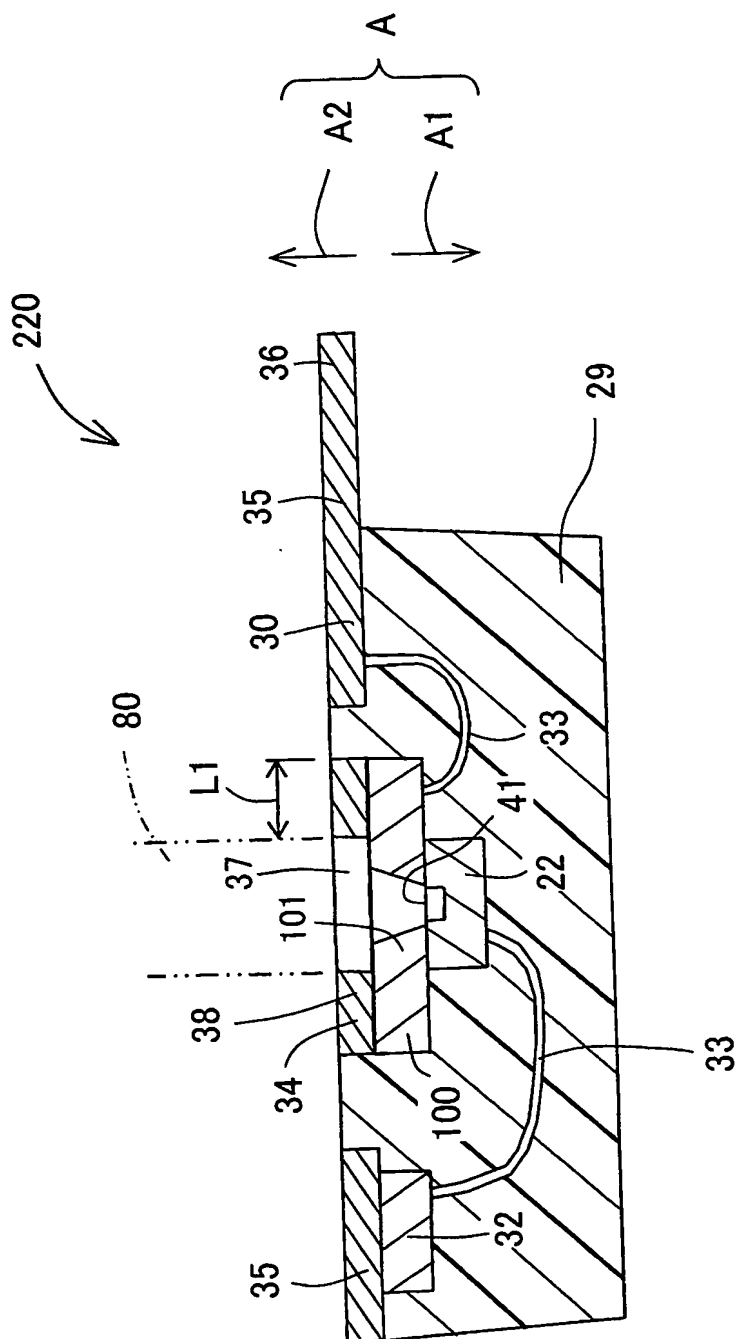
【図 5】



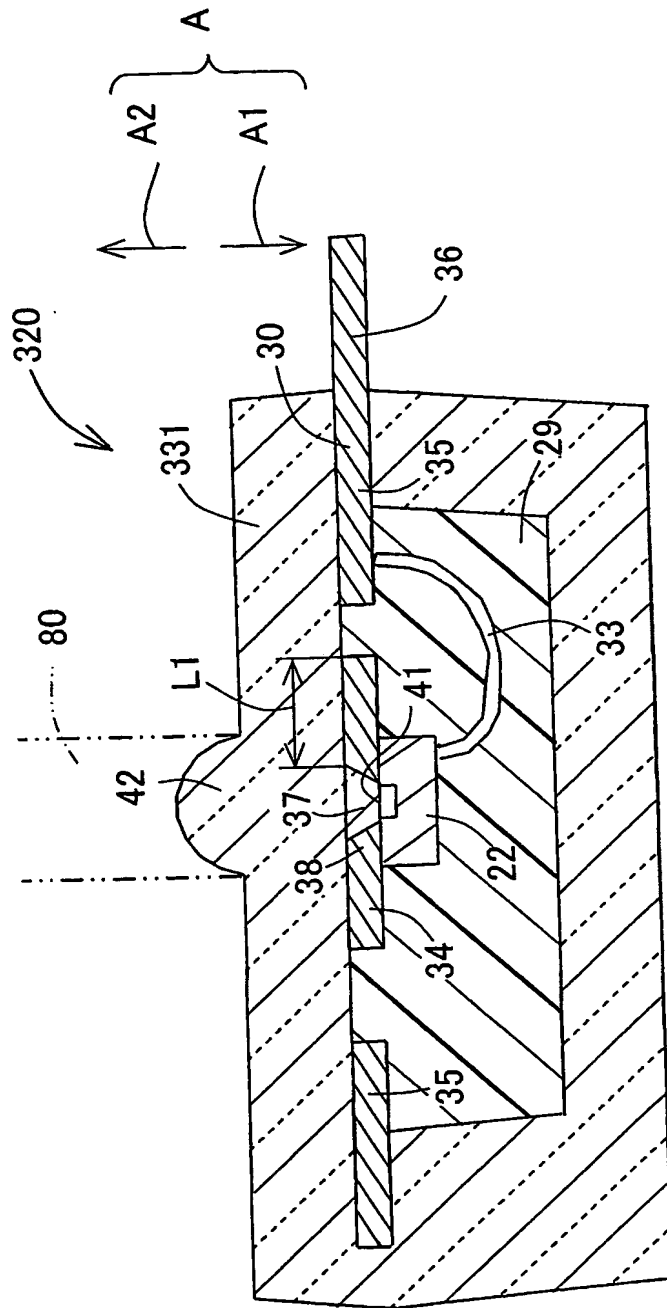
【図 7】



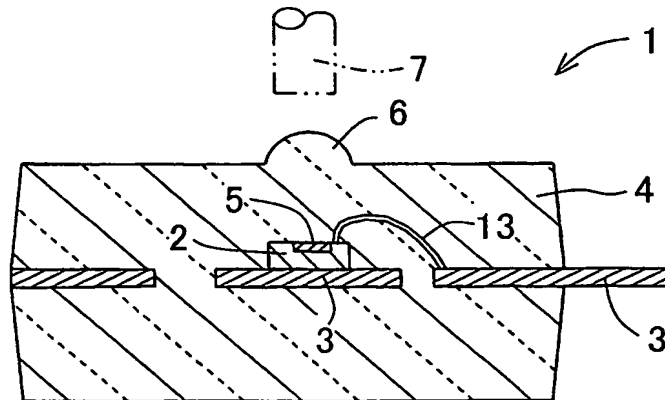
【図 8】



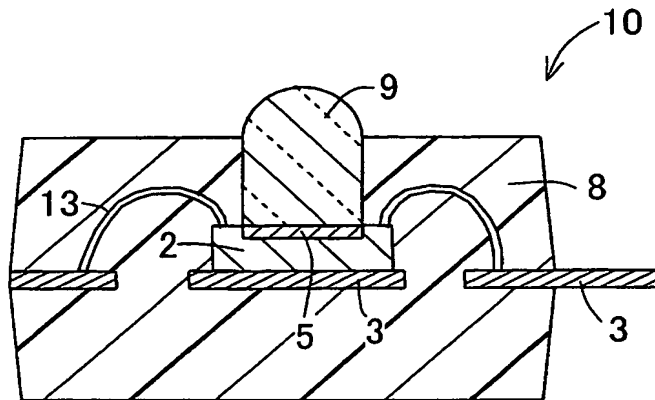
【図 9】



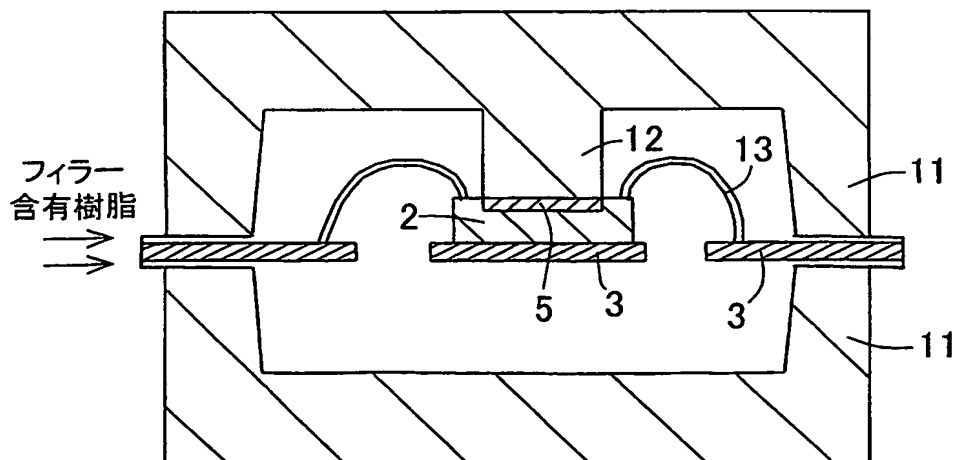
【図 11】



【図 12】



【図 13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 耐環境性に優れるとともに、小型化が可能な光学素子の封止構造体を提供する。

【解決手段】 透光部 38 を有するリードフレーム 30 に、光学面 41 が透光部 38 に臨み、透光部 38 の軸線方向一端部 48 を塞いでリードフレーム 30 に搭載される光学素子 22 と、光路 80 を除く領域に形成されて、光学素子 22 を封止する封止体 29 とを含む。光路 80 を除く領域に封止体 29 が形成されることによって、耐環境性を向上する物質を封止体に添加しても、光の利用効率の低下を防ぐことができる。またフェースダウン配置状態で、光学素子 22 がリードフレーム 30 に搭載されることによって、光学素子 22 が小型であっても、容易に封止構造体 20 を形成することができる。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 3 7 2 9 6 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 0 4 9]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市阿倍野区长池町 2 2 番 2 2 号
氏 名 シャープ株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.